

## 功耗与芯片温度计算器

这是一款根据功耗和封装/散热器特性估计结温的计算器。它利用“参数”中指定的量，计算线性调节输出的芯片功耗和温度。它还能计算外部电路板的功耗。请访问：[www.analog.com/zh/powerdis\\_vs\\_dietempcalculator](http://www.analog.com/zh/powerdis_vs_dietempcalculator)

Instructions   Troubleshooting	
Parameters	
$T_A$ Ambient temp.	70 °C
$V_+$ Pos. supply	+15 V
$V_-$ Neg. supply	-15 V
$I_Q$ Quiescent curr.	0 mA
$V_{OUT}$ Load voltage	1 V
$R_L$ Load resistance	100 ohms
$V_{GND}$ Load ground	0 V
Theta <sub>JA</sub> Theta	53.8 °C / W

$T_J$ Die junction temp.	77.53 °C
$P_{DIE}$ Die power dissipation	0.14 W
$P_{LOAD}$ Load power	0.01 W



Calculate

V 0.9.6

## 评估板

ADI公司为高速和精密放大器提供各种各样的评估板。

高速评估板：欲订购高速运算放大器评估板，请参阅各产品页面上的订购指南。所有评估板都是“裸板”，即需要订购放大器和评估板。

精密评估板：用户可订购未搭载器件的精密运算放大器评估板，以便在多种电路配置和应用电路中评估精密放大器。很容易将运算放大器、电阻、电容或任何其它器件安装到这些空白评估板上。

欲了解更多关于特定评估板上封装的布线及原理图资料，请参考下面的应用笔记：

- AN-692应用笔记，通用精密运算放大器评估板，[www.analog.com/AN-692](http://www.analog.com/AN-692)
- AN-763应用笔记，双通道通用精密运算放大器评估板，[www.analog.com/AN-763](http://www.analog.com/AN-763)
- AN-734应用笔记，SC70封装通用精密运算放大器评估板，[www.analog.com/AN-734](http://www.analog.com/AN-734)
- AN-733应用笔记，MSOP封装通用精密运算放大器评估板，[www.analog.com/AN-733](http://www.analog.com/AN-733)
- AN-732应用笔记，SOIC封装通用精密运算放大器评估板，[www.analog.com/AN-732](http://www.analog.com/AN-732)

## SPICE模型

ADI公司提供精确模拟数据手册测试测量结果的SPICE模型。各SPICE模型可以在放大器产品页面的“工具、软件和仿真模型”下面找到。在National Instruments Multisim的Analog Devices版和完整版本中，以及在许多其它电路仿真器中，也可以找到SPICE模型。

## 设计资源

ADI公司Circuits from the Lab™ 实验室电路是经过测试的参考电路，旨在解决常见的模拟、混合信号和RF设计挑战，方便设计人员轻松快捷地实现系统集成。这些电路代表易于理解的子系统级构建模块，旨在节省评估时间并简化集成。

所有实验室电路都配有完备的文档，新电路提供测试数据、设计/布局布线指南、原理图、PCB布局文件、物料清单和器件驱动程序(适用时)。大多数新电路还提供评估硬件。欲查找运算放大器电路，请访问：[www.analog.com/circuits](http://www.analog.com/circuits)



中文技术论坛是一个在线技术支持社区，使用ADI公司放大器产品的用户可以在上面提出问题，分享知识，搜索设计问题的答案。与ADI工程师及其他设计人员协作，尽在本开放式论坛：[www.analog.com/zh/forum](http://www.analog.com/zh/forum)